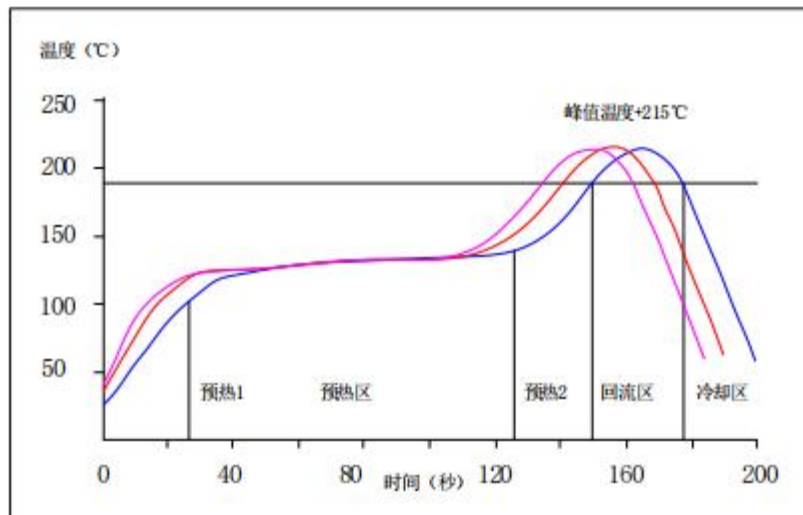


QFN塑封集成电路使用须知

- 1.使用、包装、运输过程中必须有静电防护措施:
- 2.该放大器输入输出采用AC耦合, 无需外加隔直电容, 建议电源加滤波电容0805封装10uF:
- 3.放大器用回流焊焊接时请注意, 因为器件内部采用240°C焊料共晶, 因此建议采用熔点183°C或150°C焊料焊接。推荐采用回流曲线设置如下图。
- 4.如手工焊接推荐用150°熔点焊料, 加热台加热焊接, 如用热风枪其温度不超过220°。



建议回流焊曲线图

- (a) 预热1:从室温到100°C的升温速率不要超过2°C/秒, 太快的升温速率会导致锡珠的产生。
- (b) 预热区:从100-150°C保持时间为70-100秒, 具体应取决于PCB板、元器件及回流炉的性能。
- (c) 预热2:为了减少锡珠的产生。在150°C-183°C的时间不要超过30秒, 升温速度应该在2.5-3°C/秒左右。
- (d) 回流区:推荐的最高温度在213左右, 处于液相线以上的时间在40-60秒之间。这一阶段决定焊点的外观, 时间过长会导致焊点发灰, 时间不足会导致润湿不良及残留过多。
- (e) 冷却区:推荐的冷却速率为4°C/秒。速率太快会损坏元器件或PCB, 太慢会导致元器件的移位, 以及焊点表面粗糙。

钢网开孔建议文件请联系我们获取CAD图, 谢谢!